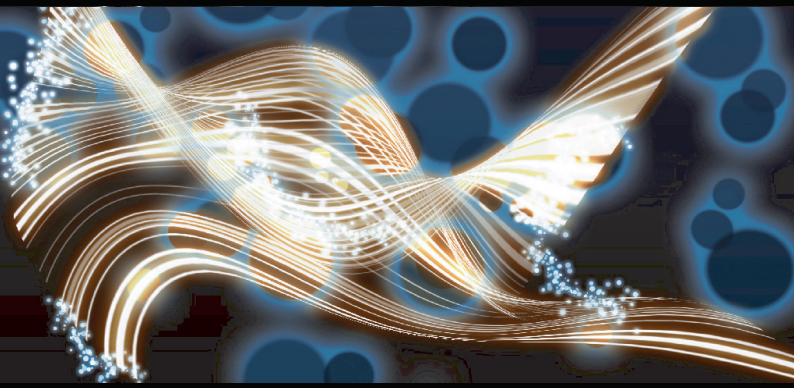
ELMAN
VALUE IN INTERCONNECTION

IS COMING IN
GERMAN MARKET

OPEN YOUR
MIND TO
INNOVATION



Sie benötigen Metal Clad/
Heatsinks Leiterplatten?

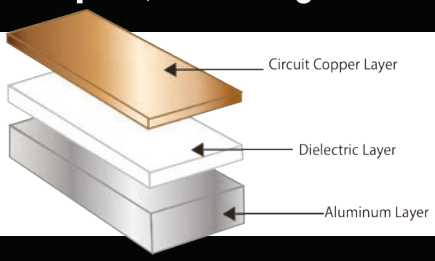
Wir bieten Ihnen fachliche
Kompetenz aus 30 Jahren
Berufserfahrung.

ELMAN

VALUE IN INTERCONNECTION

Warum sollten Sie sich für Metal Clad Leiterplatten von ELMAN entscheiden?

ELMAN bietet Ihnen europäische Spitzenleistung bei der Produktion von Metal Clad Leiterplatten (Aluminium, Kupfer, Messing)



WIR HABEN...

- die entsprechenden Technologien
- Wettbewerbsfähigkeit
- ausgezeichnete Kooperationen mit weltweit führenden Unternehmen
- Fachkenntnisse seit 1990
- Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
- Marktflexibilität

WIR BIETEN...

- die Produktion von eigenen Laminaten
- günstigere Kosten und kürzere Lieferzeiten

ELMAN

VALUE IN INTERCONNECTION

MATERIALIEN

METALLTRÄGER: Aluminium, Kupfer, Messing

DIELEKTRIKUM: PTFE-basierte Materialien, Duroplastische Materialien, Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, Standard-FR4-Materialien

KUPFERFOLIE: 17÷210µm Dicke

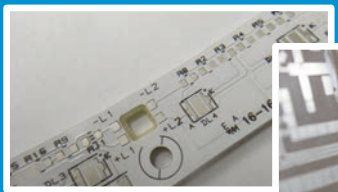
TECHNOLOGIEN

Produktion der Laminate:

- ausgezeichnete Verpressung der einzelnen Materiallagen
- Design Spezifikation (Stärke und Typ des Materials) nach Kundenvorgaben

Prozess- und Produktoptimierung:

- Zentriertechniken mittels X-ray
- Mechanische Arbeiten mit Spezialwerkzeugen
- Abzugs- und Haftfestigkeitstest
- Wärmeleitfähigkeits Test
- kontinuierliche Verbesserungen der Forschungs- und Qualitätssysteme



ELMAN

VALUE IN INTERCONNECTION

Non Standardtechniken und Konfigurationen

- elektrisch isolierte Bestückung, befestigt und verbundene
  Anschlusslöcher durch metall-plattierte Materialien

Isolierte Bauteile durch MC Material

Möglichkeit des beidseitigen Lötens der Komponenten oder Verbindungen

Ästhetische Vorteile: Fehlen von sichtbaren isolierten Leitungen sichtbar auf der Oberseite

Größenreduzierung

Vereinfachte Form der Leiterplatten

- Direct Dissipation Technik
  Herstellung von Leiterplatten, welche den direkten Kontakt zwischen Thermalpad und Metallanschluss ermöglicht
  Ätz- und Oberflächentechniken
- Verbindungstechniken mit druckempfindlichen Klebstoffen

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

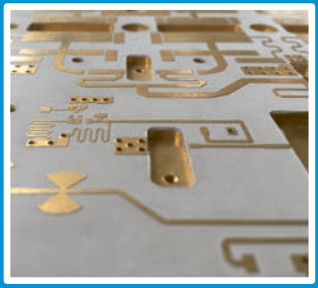
- Optimierung des Basismaterials entsprechend der Größe der Leiterplatten
- geringe Kosten durch innovative Technik mit Hilfe der Produktion vor Ort
- Spezialisierung des Anwendungsbereiches durch vor Ort angewandte Prozesse und Oberflächen

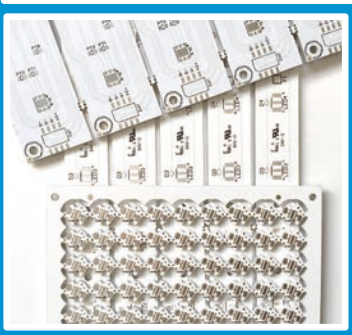
ELMAN

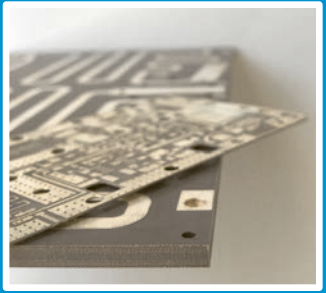
VALUE IN INTERCONNECTION

KOOPERATIONEN

- Wir zählen zu den Hauptkonsumenten von IMS Materialien in Italien.
- Wir sind in der Lage, PCB`s auf unserem Material mit besseren thermischen Eigenschaften und geringeren Kosten als unsere Wettbewerber zu liefern.
- Wir verfügen über vielseitige Versorgungswege für die Grundmateralien der weltweit führenden Unternehmen (Bergquist, Rogers, Ventec, Iteq...)







ELMAN

VALUE IN INTERCONNECTION

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS GERN UNTER

ELMAN HEADQUARTER
via 1° Maggio, 23
64015 - Nereto (TE) - ITALY

CONTACT US

Contact center: +39.0861.80671
Customer service: +39.0861.806738
Sales & Marketing director: +39.0861.806731

CONTACT US

sales@pcbelman.it

www.pcbelman.it

GERMAN OFFICE

MID solutions gmbh
molded interconnect devices

MID Solutions GmbH
Bahnhofstraße 3 b
37539 Bad Grund

Manfred Hellmich

Tel. +49 (5327) 859335
Mobile: +49 173 3791456
mhellmich@mid-solutions.de

Wolfgang Pilster

Tel. +49 (5327) 859077
Mobile: +49 173 3791465
wpilster@mid-solutions.de